

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-013

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称“中天精艺”）参与认购了东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经芯玑”）17.3762%的合伙份额，中经芯玑系为参与投资半导体产业内具备高成长性标的而成立的投资平台。

近日，中天精艺接到中经芯玑《关于对外投资项目的告知函》：经中经芯玑相关合伙人审议通过并签署了《芯玑（上海）半导体有限公司增资协议》《科睿斯半导体科技（东阳）有限公司与东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）之投资协议》《东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）关于深圳远见智存科技有限公司之 VC 轮投资协议》，对以下标的进行投资，具体如下：

一、中经芯玑对外投资的标的公司情况

（一）投资标的公司 1

1、名称：芯玑（上海）半导体有限公司（以下简称“上海芯玑”）

2、对外投资概述

中经芯玑拟出资人民币 100,000 万元认购上海芯玑新增注册资本人民币 2,333.3333 万元，剩余 97,666.6667 万元全部计入上海芯玑资本公积。

3、基本情况

（1）基本情况

公司名称：芯玑（上海）半导体有限公司

统一社会信用代码：91310116MADHT2KK0X

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：林枫

成立时间：2024 年 4 月 17 日

注册地址：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意产业园）

经营期限：2024 年 4 月 17 日至 2054 年 4 月 16 日

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）上海芯玑主要财务数据

单位：元

财务指标	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总计	145,000,204.03
负债合计	145,000,800.00
所有者权益合计	-595.97
财务指标	2024 年度 (未经审计)
营业收入	0
营业总成本	0
营业利润 (亏损以“-”号填列)	-595.97
利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-595.97
净利润 (净亏损以“-”号填列)	-595.97

（3）本次投资前后上海芯玑股东持股情况对比

股东名称	投资前		投资后	
	认缴注册资本 (万元)	股权比例 (%)	认缴注册资本 (万元)	股权比例 (%)
芯玑(海南)科技产业合伙企业(有限合伙)	1,000	100	1,000	30
东阳中经芯玑企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	2,333.3333	70

合计	1,000	100	3,333.3333	100
----	-------	-----	------------	-----

具体以最终工商登记为准。

(4) 经核查，上海芯玑不属于失信被执行人。

(5) 上海芯玑参与投资的鑫丰科技主要业务介绍

上海芯玑主要投资标的为合肥鑫丰科技有限公司（以下简称“鑫丰科技”），上海芯玑持有鑫丰科技 69.8918%的股权（具体以最终工商登记为准）。鑫丰科技专注于存储领域的封测，在封装与测试一体化服务领域拥有丰富的技术背景，凭借其技术能力和创新性解决方案为客户提供高品质的封装测试服务，广泛用于手机存储芯片和其他领域，在高端封测领域具有较强的竞争力。目前，鑫丰科技主要为客户提供有双倍速率同步动态随机存储器 DDR4、低功耗双倍速率同步动态随机存储器 LPDDR4。作为国内独立 DRAM 内存芯片封装测试企业，鑫丰科技拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力。鑫丰科技系国内首家具备 PoP（Package on Package，异质整合）量产能力的企业，具备低功耗多层封装领域及 FOPLP 国际领先、国内封测领域自动化系统（工业 4.0）领先及高端封测领域达到车规等级的技术优势，同时积极布局模块化定制芯片产品线。

鑫丰科技的具体情况如下：

1) 基本情况

公司名称：合肥鑫丰科技有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2UBB2C9Q

注册资本：27,500 万元人民币

法定代表人：高顺隆

成立时间：2019 年 11 月 25 日

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区空港经济示范区硕放路一号 A101 厂房

经营期限：2019 年 11 月 25 日至无固定期限

经营范围：集成电路设备贸易及产品制造，并提供售后服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2) 鑫丰科技主要财务数据

鑫丰科技最近一年经审计的主要财务数据：2023 年末，资产总额 507,857,458.51 元，净资产 55,146,745.07 元；2023 年度，营业收入为 178,312,315.58 元，净利润为-59,917,154.56 元。

3) 鑫丰科技股东持股情况

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
华东科技（苏州）有限公司	15,000	22.5122
芯玑（上海）半导体有限公司	46,569.2198	69.8918
合肥经开产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,561.2150	3.8439
合肥森祺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,500	3.7520
合计	66,630.4348	100

具体以最终工商登记为准。

4) 经核查，鑫丰科技不属于失信被执行人。

(二) 投资标的公司 2

1、名称：科睿斯半导体科技（东阳）有限公司

2、对外投资概述

中经芯玑拟以 40,000 万元的价款认缴科睿斯本次增加的注册资本 8,000 万元，超出注册资本部分计入科睿斯的资本公积。

3、基本情况

(1) 基本情况

公司名称：科睿斯半导体科技（东阳）有限公司

统一社会信用代码：91330783MAC6PAWW3U

注册资本：15,740 万元人民币

法定代表人：孙维佳

成立时间：2023年1月18日

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街1509号-81
(自主申报)

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；集成电路设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(2) 科睿斯主要财务数据：

单位：元

财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总计	29,473,721.47	310,338,100.46
负债合计	2,035,970.85	-6,949,475.60
所有者权益合计	27,437,750.62	317,287,576.06
财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	-	197,428.27
营业总成本	15,883,093.60	15,587,932.91
营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,904,575.38	-15,374,839.25
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-15,904,575.38	-15,374,839.25
净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,904,575.38	-15,374,839.25

(3) 本次投资前后科睿斯股东持股情况

序号	股东	出资方式	投资前		投资后	
			认缴注册资本(元)	股权比例(%)	认缴注册资本(元)	股权比例(%)
1	东阳同协科技有限公司	货币	20,000,000	12.7065	20,000,000	8.4246
2	江苏和美精艺科技有限公司	货币	8,000,000	5.0826	8,000,000	3.3698
3	东阳兴鸿微企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	16,272,727	10.3384	16,272,727	6.8546
4	东阳市才智产业发展有限公司	货币	6,818,182	4.3318	6,818,182	2.8720
5	硅创芯智(东阳)企业管理有限公司	货币	8,295,766	5.2705	8,295,766	3.4944
6	深圳经天伟地企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	37,113,325	23.5790	37,113,325	15.6332
7	东阳市中经科睿股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	57,400,000	36.4676	57,400,000	24.1786
8	华讯节能科技(深圳)有限公司	货币	2,000,000	1.2706	2,000,000	0.8425
9	北京厚米投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,200,000	0.7624	1,200,000	0.5055
10	东营厚天股权投资基金合伙企业(有限合伙)	货币	300,000	0.1906	300,000	0.1264
11	东阳中经芯玑企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	--	--	80,000,000	33.6984
总计	--	--	157,400,000	100	237,400,000	100

具体以最终工商登记为准。

(4) 经核查，科睿斯不属于失信被执行人。

(5) 科睿斯主要业务介绍

科睿斯拟定的主营业务为FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装。FCBGA载板属于IC载板，IC载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA载板(ABF载板)产品的研发及量产业务，致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状，同时填补FCBGA国内工艺领域空白。

科睿斯尚在建设中，未开始生产经营。

(三) 投资标的公司 3

1、名称：深圳远见智存科技有限公司（以下简称“远见智存”）

2、对外投资概述

中经芯玑拟以合计 15,000 万元以 28.82 元/每注册资本的价格认购远见智存 520.40816 万元的新增注册资本。其中：520.40816 万元计入注册资本，14,479.59184 万元计入资本公积。

3、基本情况

(1) 基本情况

公司名称：深圳远见智存科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MACW7ERC46

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：杨军平

成立时间：2023 年 9 月 14 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道 2 号深圳软件园 6 栋 401-39

经营期限：2023 年 9 月 14 日至 2053 年 12 月 31 日

经营范围：一般经营项目是：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务；电力电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；通讯设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；专业设计服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。

(2) 远见智存主要财务数据

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总计	0	29,461,144.48
负债合计	150.00	30,319,054.06

所有者权益合计	-150.00	-857,909.58
财务指标	2023 年度（未经审计）	2024 年度（未经审计）
营业收入	0	0
营业总成本	0	0
营业利润（亏损以“-”号填列）	-150.00	-857,759.58
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-150.00	-857,759.58
净利润（净亏损以“-”号填列）	-150.00	-857,759.58

(3) 本次投资前后远见智存股东持股情况对比

股东名称	投资前		投资后	
	认缴注册资本 (万元)	股权比例 (%)	认缴注册资本 (万元)	股权比例 (%)
珠海横琴小颗粒科技有限公司	325	65	325	31.85
北京下弦月科技发展中心（有限合伙）	175	35	175	17.15
东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	520.40816	51
合计	500	100	1020.40816	100

具体以最终工商登记为准。

(4) 经核查，远见智存不属于失信被执行人。

(5) 远见智存主要业务介绍

远见智存专注于打造超宽带存储 HBM(High Bandwidth Memory)系列芯片，在高端的智能存储芯片领域持续发力。项目创始团队自 2016 年开始组建，核心成员均来自海内外龙头企业（包括：Micron 美光和 Elpida 尔必达），由平均技术经验超 15 年的资深工程师组成，现已成为国内先进级别的自主可控全 IP 及整套 HBM 颗粒提供商，为客户提供全球最先进的近存（包括 HBM 和 3D 存储）解决方案。目前，远见智存可提供多类 HBM 产品及相关解决方案，包括绕开 TSV 和 CoWoS 两大技术瓶颈的 HBM2e，以及正在研发满足 JEDEC 标准的 HBM3/3e 产品，助力我国人工智能及计算类芯片的演进和产业发展。

二、公司参与认购的合伙企业对外投资对公司的影响

公司以科睿斯项目作为先进封装关键切入点涉入半导体行业，依托公司实际控制人及中经芯玑各合伙人的行业经验、资源整合等能力，聚焦半导体先进封装

领域开展垂直整合，提升先进封装整体解决方案的能力，助力国家半导体产业链自主可控。

此次公司参与认购的合伙企业对外投资，有利于进一步优化公司于半导体先进封装领域的产业结构，构建未来潜在利润增长点，从而提升公司综合竞争力。此举措有利于加速公司的业务转型升级进程，积极探寻并构建公司第二增长曲线，符合公司整体发展战略。

三、备查文件

1、《东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）关于对外投资项目的告知函》；

2、《芯玑（上海）半导体有限公司增资协议》；

3、《科睿斯半导体科技（东阳）有限公司与东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）之投资协议》；

4、《东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）关于深圳远见智存科技有限公司之 VC 轮投资协议》。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日